

附件1：

第八届“IC创新奖”实施方案

一、指导思想：

通过IC创新奖的申报、评选、颁布等过程活动，鼓励集成电路技术创新，引导并加强产业链合作，加速创新成果产业化，营造集成电路全产业链合作发展的良好局面。

二、奖项定位：

IC创新奖重点鼓励集成电路技术创新、成果产业化、产业链上下游合作，以体现大联盟倡导全产业链合作的理念。

三、组织机构：

主办单位：中国集成电路创新联盟（大联盟）。

第八届IC创新奖评选活动设立提名委员会和评审委员会，分别负责奖项提名与评审工作。大联盟秘书处负责具体组织实施工作，具体联系方式如下：

李斯琪 010-82995751, 13439052196

由春娟 010-82995892, 18210529773

邮 箱：lisiqi@ime.ac.cn

地 址：北京市朝阳区北土城西路3号（100029）

四、申报条件：

1、产品、技术、团队及个人奖的申报单位应在国内注册，且涉及产品、技术的研发工作应主要在国内完成；

2、申报的产品、技术应具有自主知识产权，且具有一定先进性和创新性，处于国内领先水平；

3、申报单位必须保证申报材料真实有效，严禁抄袭、盗用、提供虚假材料，且不存在任何违反国家相关法律法规及侵犯他人知识产权的情形；

4、同款产品、技术只能申报一个奖项类别，且往届已获得IC创新奖的项目不得再次重复申报。

五、奖项类别：

（一）技术创新奖：表彰在集成电路重大技术创新和关键技术开发方面取得重大突破的单位和团队（不超过10项）；

（二）成果产业化奖：表彰在集成电路创新成果产业化推进和市场拓展方面取得突出业绩的单位和团队（不超过10项）；

（三）产业链合作奖：表彰在推进集成电路产业链上下游及产学研合作方面作出突出贡献的单位和团队（不超过5项）；

（四）产业创新突出贡献奖：表彰在集成电路技术创新、成果产业化、产业链合作及创新发展服务等方面作出突出贡献的个人（不超过5项）。

六、评选流程：

第八届IC创新奖评选程序按照奖项申报、奖项受理、奖项评选和奖项颁布等四个步骤进行。

（一）奖项申报：采取单位申报与专家提名相结合。

1、符合条件的单位申报。

(1) 申报单位按要求填写第八届“IC创新奖”申报表(见附件2或通过www.ictia.cn大联盟网站进行下载)，并由单位负责人签字并加盖单位公章(含销售数据须加盖单位财务章)。

(2) 申报单位需于2024年11月03日前将纸质版与电子版申报材料提交至大联盟秘书处。具体提交方式及要求如下：

纸质版材料原件一式一份，正反面打印，简易装订。邮寄至大联盟秘书处（北京市朝阳区北土城西路3号李斯琪收）。

电子版材料（Word版和PDF盖章扫描版）命名为“奖项类别-技术类别-申报单位-项目名称”发送至大联盟秘书处邮箱（lisiqi@ime.ac.cn）。

2、提名委员会专家提名。

(二) 奖项受理: 申报单位应当在规定的时间内向大联盟秘书处提交符合要求的申报材料。在此基础上，大联盟秘书处将组织提名委员会进行提名，并对申报材料的完整性、合规性进行形式审查。

(三) 奖项评选: 大联盟秘书处拟于2024年12月组织评审委员会对获得提名的项目进行评审，并形成获奖名单。

(四) 奖项颁布: 第八届IC创新奖获奖名单将在大联盟2025年度创新大会上公布，并向各获奖单位、团队及个人颁奖。

七、相关介绍：

1. **中国集成电路创新联盟:** 是由覆盖集成电路全产业链的龙头企业、高校、研究院所和社会组织等于2017年3月22日

在北京共同发起成立的非营利性创新组织。成员单位业务范围涵盖互联网应用、信息系统集成、电子产品整机制造、集成电路设计、制造、封测、装备、材料和零部件等领域。

大联盟以国家战略为指引，以突破集成电路前沿技术为目标，鼓励开放式创新，促进产业链各环节的交流合作，优化产业技术创新的生态环境；探索各类资源协同的新机制，汇聚联盟内外和国内国际的创新资源和力量，推动产业技术水平的快速提升；促进电子信息领域3个国家科技重大专项成果的对接与深度融合；深入系统研究集成电路产业技术创新可持续发展战略，为集成电路的协同创新提供支撑。

大联盟自成立以来，围绕产业链不断完善框架体系，目前下设集成电路设计、封测、装备、材料、零部件、测试、示范性微电子学院联盟、汽车芯片和投资9个专业联盟，拥有成员单位及专业联盟成员单位900余家。

2. 提名委员会：是IC创新奖常设组织，由来自国内集成电路全产业链各领域的产业技术领军人才、战略科学家以及金融专家等组成，负责对奖项提名。

3. 评审委员会：第八届IC创新奖评审委员会由提名委员会、大联盟咨询委专家以及申报项目所属领域范围的顶级权威专家组成，负责对提名项目进行评审。

中国集成电路创新联盟

2024年10月10日